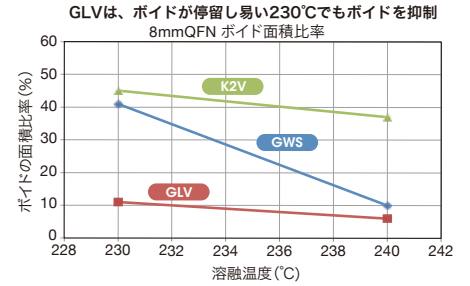


底面電極部品とチップ部品を、異なる方法でボイド低減

Reduces voids through different methods in chip components and bottom electrode components

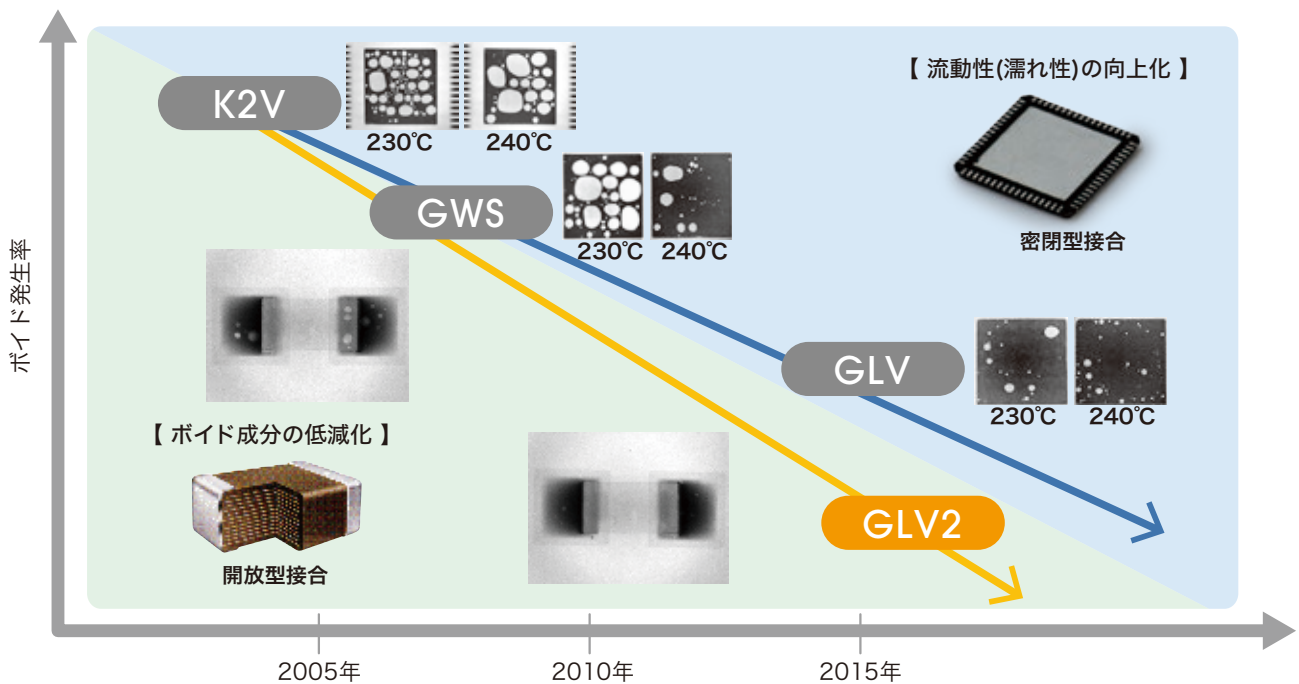
特長

- 温度上昇とボイド排出が困難な底面電極部品には『GLV』
- ボイド排出力の高いフラックスでも、増粘現象を抑制
- 微小チップ部品など、開放型接合部のボイド低減には『GLV2』
- ボイドを発生させる成分の含有を抑え、ボイドを低減



Revolutionary Products

あらゆる部品のボイドを低減する、ソルダペーストGLVシリーズ



- GLVは、良好なんだ溶融時の流動性で、ボイドを排出

